

证券代码：603459

证券简称：红板科技

公告编号：2026-023

江西红板科技股份有限公司 关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目
- 实施主体：江西红板科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州红板科技有限公司（以下简称“赣州红板”）
- 项目总投资：预计总投资不超过人民币 500,000 万元，全部为自有资金及自筹资金，主要用于建筑装修、设备购置及安装费用、配套动力设备购买安装等费用、研发投入、铺底流动资金等，具体投资金额以项目实际实施金额为准。
- 审议情况：本次投资事项经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，还需提交公司股东会审议
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
 - 1、本项目尚需完成项目备案、环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。
 - 2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。
 - 3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资将使得公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司及子公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理

性投资，注意投资风险。

一、 对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为抢抓高端电子产业发展机遇，进一步优化产品结构，布局高阶 mSAP 高端精密电路板产能，提升公司在高端 PCB 领域的综合竞争力与盈利水平，公司全资子公司赣州红板拟在现有厂区内实施高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） --增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☒投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：不超过 500,000 ☐ 尚未确定
出资方式	☒现金 ☒自有资金 ☒其他：自筹资金 ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☐是 ☒否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目的议案》，同意公司全资子公司赣州红板使用不超过 500,000 万元的自有资金及自筹资金投资建设高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资项目基本情况

(一) 投资标的概况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	高阶 mSAP 高端精密电路板产业化项目
项目主要内容	本项目利用赣州红板现有厂房，新建高标准洁净生产车间，引进高端精密电镀、曝光、蚀刻、检测等电路板全流程生产设备，配套建设公用工程及环保设施，搭建智能化生产管理系统，形成规模化高阶 mSAP 电路板生产能力。
建设地点	江西省赣州市龙南市经济技术开发区赣州红板现有厂区内，利用现有厂房增加生产设备，不新增建设用地
项目总投资金额（万元）	本项目预计总投资不超过 500,000 万元，主要用于建筑装修、设备购置及安装费用、配套动力设备购买安装等费用、研发投入、铺底流动资金等，具体投资金额以项目实际实施金额为准。
上市公司投资金额（万元）	不超过 500,000 万元（最终以项目建设实际实施金额为准）
项目建设期	48 个月，分阶段完成设备进场、安装调试、试生产等工作
预计开工时间	2027 年 1 月
预计投资收益率	满足公司内部收益率要求
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

(二) 项目市场定位及可行性分析

当前高端电子产业持续升级，PCB 载板化趋势日益显著，高阶 mSAP 产能整体处于紧缺状态，行业整体景气度稳步提升，直接带动上游高精度、高密度、高可靠性印制电路板的市场需求大幅增长。公司深耕高阶 HDI、高精密、高可靠性电路板领域多年，积累了扎实的技术储备、优质的客户资源及丰富的生产经验，综合优势突出。本次产业化项目是公司聚焦核心主业、布局高阶 HDI 和 mSAP 赛道、优化产品结构、提升高附加值产品占比的重要举措，契合当前行业市场发展趋势与公司长期战略规划。

项目建成达产后，将主要生产高阶 HDI 和 mSAP 高端精密电路板等核心高端产品，产品可广泛适配高端通讯电子、高端消费电子、高端显示等应用场景,主

要供应国内外高端电子领域优质头部客户。

本项目符合国家高端 PCB 技术升级、电子信息产业提质升级、先进制造业发展等相关产业政策导向，贴合江西省电子信息产业高端化、精细化、智能化的整体发展布局。现阶段，PCB 载板化趋势持续深化，市场对 mSAP 和高阶 HDI 电路板的采购需求稳步增长，高端精密 PCB 产品市场成长空间充足。公司深耕 PCB 制造领域多年，熟练掌握 mSAP 和高阶 HDI 生产所需的精密线路加工、超薄铜箔蚀刻、高精度对位等核心工艺，依托专业研发团队与完善的技术体系，可稳定实现核心产品的规模化量产。

赣州红板现有厂区基础设施及配套条件完备，本次产业化项目依托现有厂区资源开展建设，具备建设成本可控、项目落地快、投产效率高的优势。公司深耕高端电子产业链，积累了稳定优质的行业客户资源，当前在手订单充足，可有效承接并消化本次项目的新增产能，保障产能有效落地。项目资金可通过自有资金、银行贷款等多元方式统筹筹措，资金来源稳定可控，能够充分满足项目建设及后续运营需求。相较于常规电路板，本次项目投产的高阶 mSAP 电路板产品精度要求更高、附加值更优、市场竞争优势明显，投产后能够有效夯实公司营收与利润基础，提升企业整体盈利能力与市场竞争力。综合政策适配性、技术基础、市场需求、产能消化及经济效益等多维度研判，本项目实施具备充分的必要性与可行性。

三、 本次投资的目的及对公司的影响

（一）投资目的

本次投资有利于公司把握高端电子行业增长机遇，扩充高附加值产品产能，进一步提升市场占有率；升级生产工艺与装备水平，巩固公司在高精密 PCB 领域的技术优势，强化核心竞争力；优化整体产品结构，提升整体盈利水平，助力公司实现持续稳健发展。

（二）对上市公司的影响

本次产业化项目围绕公司 PCB 主业开展，符合公司长期发展战略。本项目对公司 2026 年度经营业绩不构成重大影响，但随着项目的稳步推进与实施，预计将进一步完善公司高端产品布局，增强子公司经营实力与盈利能力，对公司未来业务发展和经营效益产生积极影响。

本次项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不会对公司正常生产经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、 风险提示

1、本项目尚需完成项目备案、环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资将使得公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司及子公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。

江西红板科技股份有限公司董事会

2026年7月24日